

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/202271 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 11/08 (2006.01) C09J 7/30 (2018.01)
C09J 163/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/009903
- (22) 国際出願日: 2022年3月8日(08.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-052761 2021年3月26日(26.03.2021) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 大谷 洋多 (OTANI, Yota); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 丸山 弘光 (MARUYAMA, Hiromitsu); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 森田 稔 (MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: DICING DIE ATTACH FILM AND METHOD FOR PRODUCING SAME, AND SEMICONDUCTOR PACKAGE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: ダイシングダイアタッチフィルム及びその製造方法、並びに半導体パッケージ及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: A dicing die attach film which comprises a dicing film and a die attach film that is superposed on the dicing film, wherein: a surface of the die attach film has an arithmetic mean roughness Ra1 of 0.05 μ m to 2.50 μ m, the surface being in contact with the dicing film; and the ratio of Ra1 to the arithmetic mean roughness Ra2 of another surface of the die attach film, the other surface being on the reverse side from the surface that is in contact with the dicing film, is from 1.05 to 28.00.

(57) 要約: ダイシングフィルムと、このダイシングフィルム上に積層されたダイアタッチフィルムとを有するダイシングダイアタッチフィルムであって、前記ダイアタッチフィルムは、前記ダイシングフィルムと接する面の算術平均粗さRa1が0.05～2.50 μ mであり、前記ダイアタッチフィルムの前記ダイシングフィルムと接する面とは反対側の面の算術平均粗さRa2に対する、前記Ra1の比の値が1.05～28.00である、ダイシングダイアタッチフィルム。

[続葉有]

WO 2022/202271 A1

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）